



本社：〒160-8366  
東京都新宿区西新宿 6 丁目 24 番 1 号  
西新宿三井ビルディング

報告書番号：PCN#20120727001A  
2012 年 8 月 14 日

お客様各位

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社  
営業・技術本部 カスタマドキュメント  
マネージャ 牧 達郎

HPA/PWR SOT23 (DBV) パッケージ 一部製品 Cu(銅)ワイヤ/リードフレーム追加のご案内

(既報 255 製品からの対象除外 111 製品の連絡)

(初版 PCN20120727001 2012 年 8 月 1 日発行)

拝啓 貴社益々ご清栄の事とお喜び申し上げます。平素は弊社製品のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、標題の件につきましてご連絡させていただきます。ご査収の程、宜しく願い申し上げます。

今回のお知らせは、変更実施についての追加連絡になります。変更の詳細は、次頁以降をご参照下さい。

お客様におかれましては、本通知発行日後、**30 日**以内に通知確認のご連絡をお願いいたします。また、30 日以内にご連絡が無い場合には、本変更をご承認いただけただけのものとして判断させていただきます。変更品評価用サンプルもしくは追加データご入用の場合には、本通知発行日後 30 日以内にご依頼をお願いいたします。

変更品の出荷につきましては、お客様との早期変更実施の個別契約を締結している場合を除いては、本通知発行日より **90 日**以降に予定いたしております。この通知期間は、弊社品質標準に基づいております。

本通知は、いかなる製品の製造終了に関する状況を変更するものではございません。既に製造終了の連絡をさせていただいている場合には、本通知によって、既通知の最終受注日及び最終出荷日が延長されることはございません。

本通知は、通知日前 24 ヶ月以内に本変更対象製品をご購入いただいたお客様に連絡させていただいております。

尚、変更時期につきましては、在庫状況により異なりますので、担当営業にお問い合わせ下さい。また、ご不明な点、ご質問等がございましたら、担当営業或いは [pcn\\_tij@list.ti.com](mailto:pcn_tij@list.ti.com) にお問い合わせ下さい。

以上

変更概要

通知タイプ	<input type="checkbox"/> Initial notice (Plan)	<input checked="" type="checkbox"/> Final notice		
変更概要	Design/Specification	<input type="checkbox"/> Design	<input type="checkbox"/> Electrical	<input type="checkbox"/> Mechanical
	Wafer Fab	<input type="checkbox"/> Site	<input type="checkbox"/> Process	<input type="checkbox"/> Material
	Wafer Bump	<input type="checkbox"/> Site	<input type="checkbox"/> Process	<input type="checkbox"/> Material
	<input checked="" type="checkbox"/> Assembly	<input type="checkbox"/> Site	<input checked="" type="checkbox"/> Process	<input checked="" type="checkbox"/> Material
	Test	<input type="checkbox"/> Site	<input type="checkbox"/> Process	
	Others	<input type="checkbox"/> Packing/Shipping/Labeling	<input type="checkbox"/> -	
変更内容	下記変更について既報 255 製品からの対象除外 111 製品の連絡になります。 HPA/PWR SOT23 (DBV) パッケージ一部製品 Cu (銅) ワイヤ/リードフレーム追加 現行 : Au (金) 線, NiPdAu 表面処理 変更後 : Au (金) 線, NiPdAu 表面処理, Cu (銅) 線, Matte-Sn 表面処理			
対象製品	対象製品リスト参照			
変更時期	11 月中旬の出荷より予定しています。			
品質認定試験	<input checked="" type="checkbox"/> 計画	<input type="checkbox"/> 終了		
製品表示	<input type="checkbox"/> 変更無し	<input checked="" type="checkbox"/> 変更あり		
備考	—			

変更内容

内容：今回のお知らせは、下記変更について既報255製品からの対象除外111製品の連絡になります。末尾“G4”付製品は、本変更の対象ではありませんので、変更対象から除外します。また、その他3製品も対象から除外します。下記対象製品リストを参照ください。

弊社 HPA (ハイパフォーマンスアナログ) /PWR (パワーマネジメント) SOT23 (DBV) パッケージ 一部製品について、現行 Au (金) 線ボンディングワイヤ/NiPdAu表面処理リードフレームを使用して製造していますが、機械/電気的特性の向上、同種製品の組立技術推移対応及び供給能力/部材調達利便性向上の為に、これに加えて、Cu (銅) 線ボンディングワイヤ/Matte-Sn表面処理リードフレームを追加します。その他の部材変更については、下記を参照ください。組立サイトの変更はありません。尚、今回の変更で、製品についての互換性(寸法/公差), 外観, 動作特性, 品質, 信頼性への影響はありません。

変更内容	現行	変更後
ボンディングワイヤ	Au (金) 線	Au (金) 線 Cu (銅) 線
リードフレーム表面処理	NiPdAu	NiPdAu Matte-Sn

	現行	追加認定
ボンディングワイヤ部材	Au	Cu
モールド樹脂 部材番号	R-13	R-17
リードフレーム端子表面処理	NiPdAu	Matte Sn

理由：機械/電気的特性の向上、同種製品の組立技術推移対応及び供給能力/部材調達利便性向上の為

詳細：

本変更実施以降、対象製品の鉛フリー対応製品は**単一製品名**に統一されます。

例えば、TMP125AIDBVT の製品名で Matte-Sn もしくは NiPdAu 表面処理の製品が出荷されることになります。

NiPdAu 表面処理製品を指定する場合は、例えば、TMP125AIDBVTG4 のように、末尾“G4”付製品名で発注することが可能になります。

対象製品リスト

対象製品名				
□: 既報対象品 取消線: 対象除外品				
HPA00027DBVR	TPS2552DBVT	TPS731125DBVRG4	TPS73225DBVR	TPS79101DBVTG4
HPA00028DBVR	TPS2552DBVT-1	TPS731125DBVT	TPS73225DBVRG4	TPS79118DBVR
HPA00029DBVR	TPS2553DBVR	TPS731125DBVTG4	TPS73225DBVT	TPS79118DBVRG4
HPA00104DBVR	TPS2553DBVR-1	TPS73115DBVR	TPS73225DBVTG4	TPS79118DBVT
HPA00212DBVR	TPS2553DBVT	TPS73115DBVRG4	TPS73230DBVR	TPS79118DBVTG4
HPA00237DBVR	TPS2553DBVT-1	TPS73115DBVT	TPS73230DBVRG4	TPS79133DBVR
HPA00287DBVR	TPS61040DBVR	TPS73115DBVTG4	TPS73230DBVT	TPS79133DBVRG4
HPA00357DBVR	TPS61040DBVRG4	TPS73118DBVR	TPS73230DBVTG4	TPS79133DBVT
HPA00408DBVR	TPS61041DBVR	TPS73118DBVRG4	TPS73233DBVR	TPS79133DBVTG4
HPA00427DBVR	TPS61041DBVRG4	TPS73118DBVT	TPS73233DBVRG4	TPS79147DBVR
HPA00444A1DBVT	TPS72301DBVR	TPS73118DBVTG4	TPS73233DBVT	TPS79147DBVRG4
HPA00450DBVR	TPS72301DBVRG4	TPS73125DBVR	TPS73233DBVTG4	TPS79147DBVT
HPA00457DBVR	TPS72301DBVT	TPS73125DBVRG4	TPS73250DBVR	TPS79147DBVTG4
HPA00658DBVR	TPS72301DBVTG4	TPS73125DBVT	TPS73250DBVRG4	TPS79201DBVR
HPA00660DBVR	TPS72325DBVR	TPS73125DBVTG4	TPS73250DBVT	TPS79201DBVRG4
HPA00672DBVR	TPS72325DBVRG4	TPS73130DBVR	TPS73250DBVTG4	TPS79201DBVT
HPA00709DBVR-1	TPS72325DBVT	TPS73130DBVRG4	TPS73601DBVR	TPS79201DBVTG4
HPA00714DBVR	TPS72325DBVTG4	TPS73130DBVT	TPS73601DBVRG4	TPS79225DBVR
HPA00734DBVR	TPS73001DBVR	TPS73130DBVTG4	TPS73601DBVT	TPS79225DBVRG4
HPA01085DBVR	TPS73001DBVRG4	TPS73131DBVR	TPS73601DBVTG4	TPS79225DBVT
HPA01085DBVR	TPS73001DBVT	TPS73131DBVRG4	TPS73615DBVR	TPS79225DBVTG4
<del>SN0309051DBVRG</del>	TPS73001DBVTG4	TPS73131DBVT	TPS73615DBVRG4	TPS79228DBVR
SN6501DBVR	TPS73018DBVR	TPS73131DBVTG4	TPS73615DBVT	TPS79228DBVRG4
TMP125A1DBVT	TPS73018DBVRG4	TPS73133DBVR	TPS73615DBVTG4	TPS79228DBVT
<del>TMP125A1DBVTG4</del>	TPS73018DBVT	TPS73133DBVRG4	TPS73618DBVR	TPS79228DBVTG4
TMP300A1DBVR	TPS73018DBVTG4	TPS73133DBVT	TPS73618DBVRG4	TPS79230DBVR
TMP300A1DBVT	TPS73025DBVR	TPS73133DBVTG4	TPS73618DBVT	TPS79230DBVRG4
TPS2041BDBVR	TPS73025DBVRG4	TPS73150DBVR	TPS73618DBVTG4	TPS79230DBVT
TPS2041BDBVRG4	TPS73025DBVT	TPS73150DBVRG4	TPS73625DBVR	TPS79230DBVTG4
TPS2041BDBVT	TPS73025DBVTG4	TPS73150DBVT	TPS73625DBVRG4	TPS79301DBVR
TPS2041BDBVTG4	TPS730285DBVR	TPS73150DBVTG4	TPS73625DBVT	TPS79301DBVRG4
TPS2051BDBVR	TPS730285DBVRG4	TPS73201DBVR	TPS73625DBVTG4	TPS79301DBVT
TPS2051BDBVRG4	TPS730285DBVT	TPS73201DBVRG4	TPS73630DBVR	TPS79301DBVTG4
TPS2051BDBVT	TPS730285DBVTG4	TPS73201DBVT	TPS73630DBVRG4	TPS79318DBVR
TPS2051BDBVTG4	TPS73028DBVR	TPS73201DBVTG4	TPS73630DBVT	TPS79318DBVRG4
TPS2051CDBVR	TPS73028DBVRG4	TPS73213DBVR	TPS73630DBVTG4	TPS79318DBVT
TPS2051CDBVT	TPS73028DBVT	TPS73213DBVRG4	TPS73632DBVR	TPS79318DBVTG4
TPS2065CDBVR	TPS73028DBVTG4	TPS73213DBVT	TPS73632DBVRG4	TPS79325DBVR
TPS2065CDBVT	TPS73030DBVR	TPS73213DBVTG4	TPS73632DBVT	TPS79325DBVRG4
TPS2065DBVR	TPS73030DBVRG4	TPS73215DBVR	TPS73632DBVTG4	TPS793285DBVR
TPS2065DBVT	TPS73030DBVT	TPS73215DBVRG4	TPS73633DBVR	TPS793285DBVRG4
TPS2550DBVR	TPS73030DBVTG4	TPS73215DBVT	TPS73633DBVRG4	TPS793285DBVT
TPS2550DBVRG4	TPS73033DBVR	TPS73215DBVTG4	TPS73633DBVT	TPS793285DBVTG4
TPS2550DBVT	TPS73033DBVRG4	TPS73218DBVR	TPS73633DBVTG4	TPS79328DBVR
TPS2550DBVTG4	TPS73033DBVT	TPS73218DBVRG4	TPS73643DBVR	TPS79328DBVRG4
TPS2551DBVR	TPS73033DBVTG4	TPS73218DBVT	TPS73643DBVRG4	TPS79330DBVR
TPS2551DBVRG4	TPS73101DBVR	TPS73218DBVTG4	TPS73643DBVT	TPS79330DBVRG4
TPS2551DBVT	TPS73101DBVRG4	TPS73219DBVR	TPS73643DBVTG4	TPS79333DBVR
TPS2551DBVTG4	TPS73101DBVT	TPS73219DBVRG4	TPS79101DBVR	TPS79333DBVRG4
TPS2552DBVR	TPS73101DBVTG4	TPS73219DBVT	TPS79101DBVRG4	TPS793475DBVR
TPS2552DBVR-1	TPS731125DBVR	TPS73219DBVTG4	TPS79101DBVT	TPS793475DBVRG4

製品表示

今回の変更に伴い、出荷ラベルに記載の ECAT コードが下記の様になります。

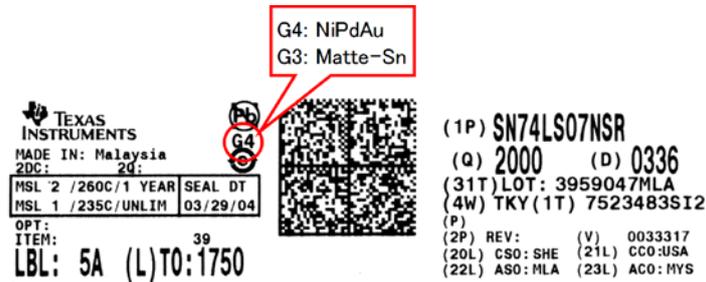


図1 出荷ラベルの例

信頼性試験

信頼性試験計画				
信頼性試験期間	開始	2012年9月	終了	2013年2月
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	TPS2051BDBVR	-	-	
Assembly Site:	NFME	Package/Code/Pins:	SOT-23/DBV/5	
Mount Compound:	A-03	Mold Compound:	R-17	
Bond Wire:	1.3 Mil Dia., Cu	Lead frame (Finish, Base):	Matte Sn, Cu	
MSL:	JEDEC L-1/260C	-	-	
信頼性試験計画				
Reliability Test	Condition / Duration		Sample Size	
Electrical Characterization	-		30	
**T/C	-65C/150C, 500 Cyc		77	
Manufacturability (Assembly)	per mfg. Site specification		per spec	
Moisture Sensitivity	JEDEC L-1/260C		12	
Notes: ** Preconditioning sequence: JEDEC L-1/260C.				

信頼性試験計画				
信頼性試験期間	開始	2012年9月	終了	2013年2月
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	TPS2051CDBVR	-	-	
Assembly Site:	NFME	Package/Code/Pins:	SOT-23/DBV/5	
Mount Compound:	A-03	Mold Compound:	R-17	
Bond Wire:	1.3Mil Dia., Cu	Lead frame (Finish, Base):	Matte Sn, Cu	
MSL:	JEDEC L-2/260C	-	-	
信頼性試験計画				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size		
		Lot1	Lot2	Lot3
** High Temp Operating Life	125C, 500, 1000 Hrs	77	77	77
Electrical Characterization	-	per spec	per spec	per spec
**High Temp. Storage Bake	150C, 500, 1000 Hrs	77	77	77
**Biased HAST	130C/85%RH, 96 Hrs	78	78	78
**Unbiased HAST	130C/85%RH, 96 Hrs	77	77	77
**T/C	-65C/150C, 500 Cyc	77	77	77
Manufacturability (Assembly)	per mfg. Site specification	per spec	per spec	per spec
Moisture Sensitivity	JEDEC L-2/260C	12	12	12
Notes: ** Preconditioning sequence: JEDEC L-2/260C.				

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

信頼性試験計画				
信頼性試験期間	開始	2012年9月	終了	2013年2月
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	TPS2553DBVR	-	-	
Assembly Site:	NFME	Package/Code/Pins:	SOT-23/DBV/6	
Mount Compound:	A-03	Mold Compound:	R-17	
Bond Wire:	2.0Mil Dia., Cu	Lead frame (Finish, Base):	Matte Sn, Cu	
MSL:	JEDEC L-1/260C	-	-	
信頼性試験計画				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size		
		Lot1	Lot2	Lot3
** High Temp Operating Life	125C, 500, 1000 Hrs	77	77	77
Electrical Characterization	-	per spec	per spec	per spec
**High Temp. Storage Bake	150C, 500, 1000 Hrs	77	77	77
**Unbiased HAST	130C/85%RH, 96 Hrs	77	77	77
**T/C	-65C/150C, 500 Cyc	77	77	77
Manufacturability (Assembly)	per mfg. Site specification	per spec	per spec	per spec
Moisture Sensitivity	JEDEC L-1/260C	12	12	12
Notes: ** Preconditioning sequence: JEDEC L-1/260C.				

信頼性試験計画				
信頼性試験期間	開始	2012年9月	終了	2013年2月
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	TPS61041DBVR	-	-	
Assembly Site:	NFME	Package/Code/Pins:	SOT-23/DBV/5	
Mount Compound:	A-03	Mold Compound:	R-17	
Bond Wire:	1.3Mil Dia., Cu	Lead frame (Finish, Base):	Matte Sn, Cu	
MSL:	JEDEC L-1/260C	-	-	
信頼性試験計画				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size		
		Lot1	Lot2	Lot3
Electrical Characterization	-	per spec	per spec	per spec
**High Temp. Storage Bake	150C, 500, 1000 Hrs	77	77	77
**Biased HAST	130C/85%RH, 96 Hrs	78	78	78
**Unbiased HAST	130C/85%RH, 96 Hrs	77	77	77
**T/C	-65C/150C, 500 Cyc	77	77	77
Manufacturability (Assembly)	per mfg. Site specification	per spec	per spec	per spec
Moisture Sensitivity	JEDEC L-1/260C	12	12	12
Notes: ** Preconditioning sequence: JEDEC L-1/260C.				